

Baustofffreigaben - Verarbeitungsempfehlungen

CLAYTEC - Baustoffe aus Lehm

Massivbauuntergründe	Lehm-Unterputz D 15 mm oder Lehmputz SanReMo D 6 mm oder beliebiger ausreichend ebener Untergrund, c-flex Heizfilm einarbeiten in Lehmklebe- und Armierungsmörtel (durchgängige Deckung auf der Oberfläche) Armierungslage aus Lehmklebe- und Armierungsmörtel und Glasgewebe* YOSIMA Lehm-Designputz oder DIE WEISSE und CLAYFIX Lehm-Anstrich (falls Armierungslage nicht eben genug, Vorbehandlung mit Zwischenlage aus Lehm-Oberputz fein 06)
Trockenbau- und Innendämmunguntergründe	Lehmbauplatten, Holzfaserbauplatten (HFA), Holzfaserdämmplatten (HFD) oder Gipskarton/Gipsfaserplatten (bei diesen Stößen armiert/geklebt, mit Sperrgrund und DIE GELBE), c-flex Heizfilm einarbeiten in Lehmklebe- und Armierungsmörtel Armierungslage aus Lehmklebe- und Armierungsmörtel und Glasgewebe YOSIMA Lehm-Designputz oder DIE WEISSE und CLAYFIX Lehm-Anstrich (falls Armierungslage nicht eben genug, Vorbehandlung mit Zwischenlage aus Lehm-Oberputz fein 06)

*) Sofern das nötig ist. Der Putzaufbau würde keine Armierung notwendig machen.

www.claytec.de